

# 株式会社東京精密 2020年度(2021年3月期) 第2四半期 決算説明会

2020年11月11日

#### ◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- ▶ 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ▶ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ▶ 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

#### ◆ 表記データ・用語について

- ▶ 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ▶ 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

#### ◆ 監査について

- ▶ 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## 次第

- ◆ 2020年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2020年度 通期業績予想
- ◆ 中期目標に関して
- ◆ 質疑応答

- 当社 説明会参加者
  - 代表取締役社長CEO 吉田 均
  - 代表取締役副社長COO 木村 龍一
  - 代表取締役CFO 川村 浩一

## 2020年度 第2四半期 連結業績



半期業績(億円)	2019年度		2020年度				
	上期	下期	上期	業績予想	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	383	493	396			-20%	+3%
売上高	420	459	451	470	-19	-2%	+7%
営業利益 (営業利益率)	56 (13%)	67 (15%)	63 (14%)	76 (16%)	-13	-6%	+12%
経常利益	57	66	64	76	-12	-3%	+12%
当期純利益	43	29	47	56	-9	+62%	+10%

四半期業績(億円)	2019年度				2020年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	187	196	225	268	187	210	+12%	+7%
売上高	180	240	222	237	211	240	+14%	+0%
営業利益 (営業利益率)	18 (10%)	38 (16%)	34 (15%)	33 (14%)	32 (15%)	31 (13%)	-2%	-18%
経常利益	19	38	34	32	33	31	-8%	-20%
当期純利益	14	29	23	6	25	22	-7%	-23%

- 上期は新型コロナによる計測機器セグメント減収を半導体製造装置セグメントがカバーし、全体で前年同期比増収増益

Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 上期業績は、新型コロナの影響による計測機器セグメントの減収を半導体装置セグメントの増収がカバーし、前年同期比増収増益

# 半導体製造装置セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2019年度		2020年度				
	上期	下期	上期	業績予想	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	229	348	288			-17%	+26%
売上高	276	286	334	355	-21	+17%	+21%
営業利益 (営業利益率)	38 (14%)	42 (15%)	57 (17%)			+37%	+51%

四半期業績(億円)	2019年度				2020年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	107	122	154	195	129	159	+23%	+31%
売上高	117	159	141	146	154	180	+16%	+13%
営業利益 (営業利益率)	14 (12%)	24 (15%)	21 (15%)	20 (14%)	28 (18%)	29 (16%)	+0%	+19%

- ▶ 上期は 前年同期比、前半期比ともに増収増益
- ▶ 受注は米中貿易摩擦の影響を受けるも、中国現地メーカー向け、並びに電子部品メーカー向けが下支えとなり、前年同期比で増加

- 2020年度上期は 前年同期比、前半期比ともに増収増益
- 受注については、米中貿易摩擦の影響を受けたものの、電子部品メーカー向け、中国現地メーカー向けの受注が底支えし、前年同期比増

# 半導体 - 売上高, 営業利益



売上高(億円)

営業利益(億円)



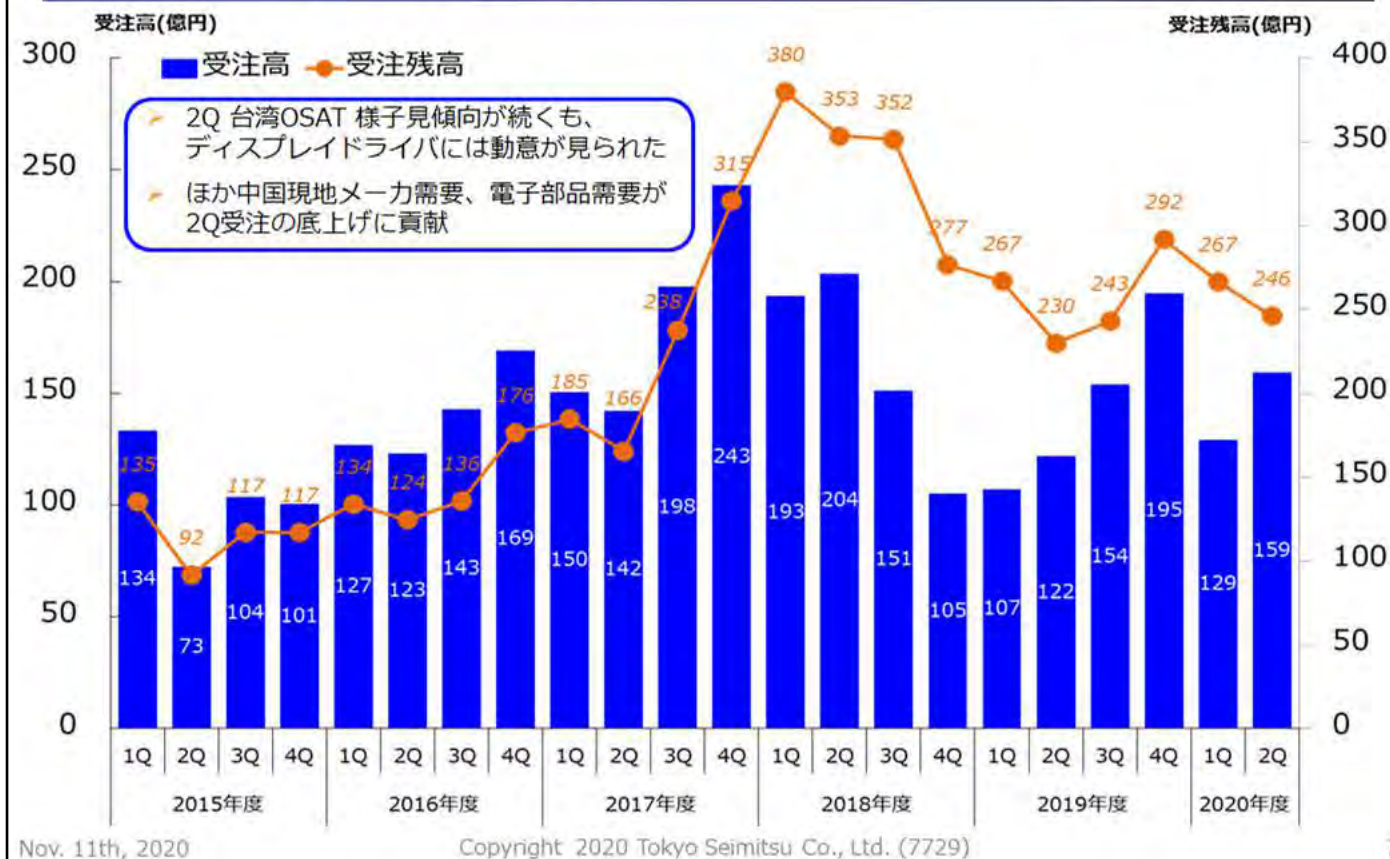
Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

6

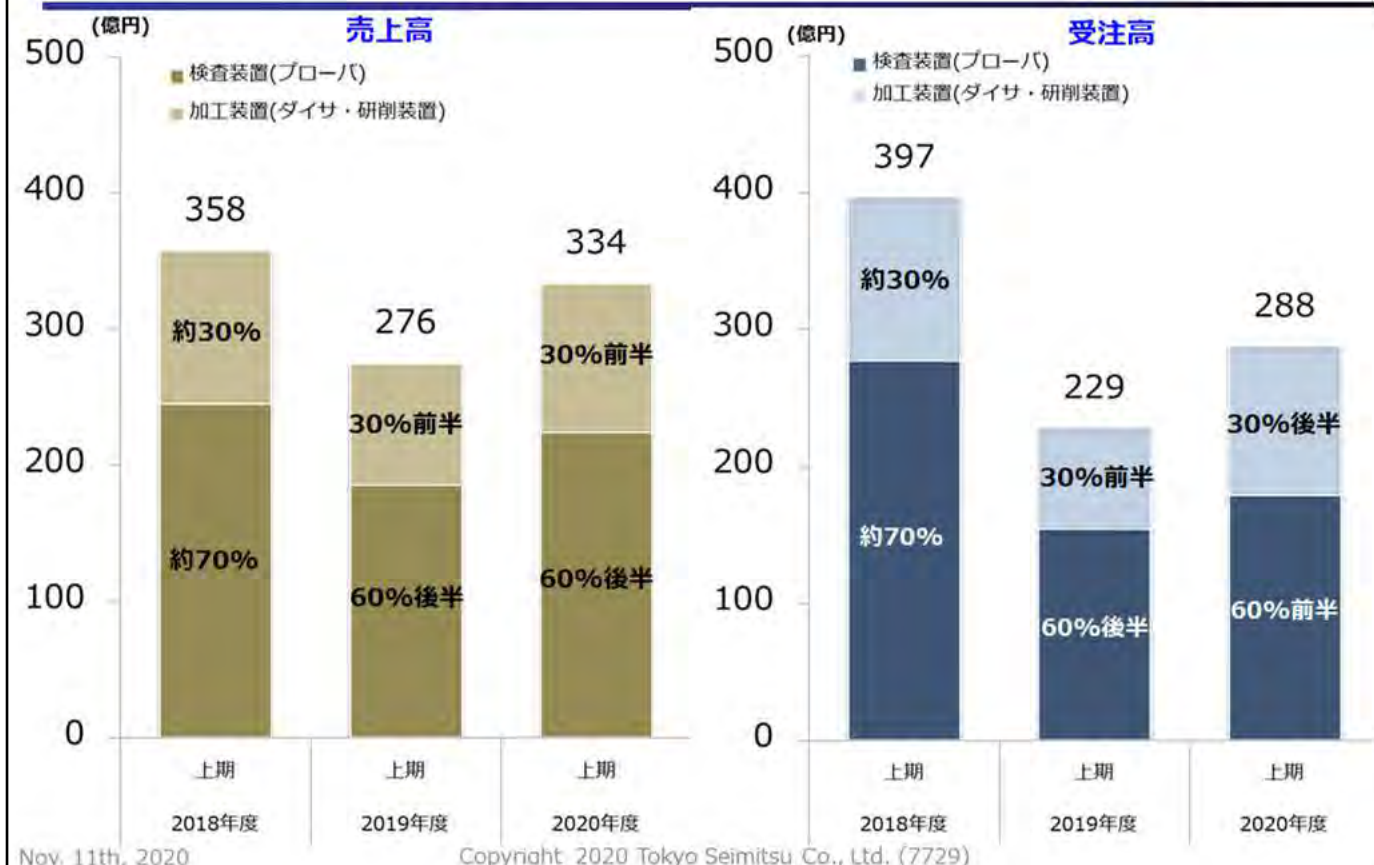
- 2020年度第2四半期の売上高は、第1四半期対比増加

# 半導体 - 受注高, 受注残高



- 2020年度第2四半期受注は 電子部品関連の受注, 中国の半導体・電子部品関連メーカーからの発注を軸に, 前四半期比, 前年同期比 とともに増加
- 期末受注残高は 高水準を維持

# 半導体 - 製品別動向



○ 2020年度上期の製品別比率：

- 売上高 検査装置(プローバ) 6割後半
- 加工装置(ダイサ・研削装置) 3割前半
- 受注高 検査装置 6割前半
- 加工装置 3割後半



# 計測機器セグメント



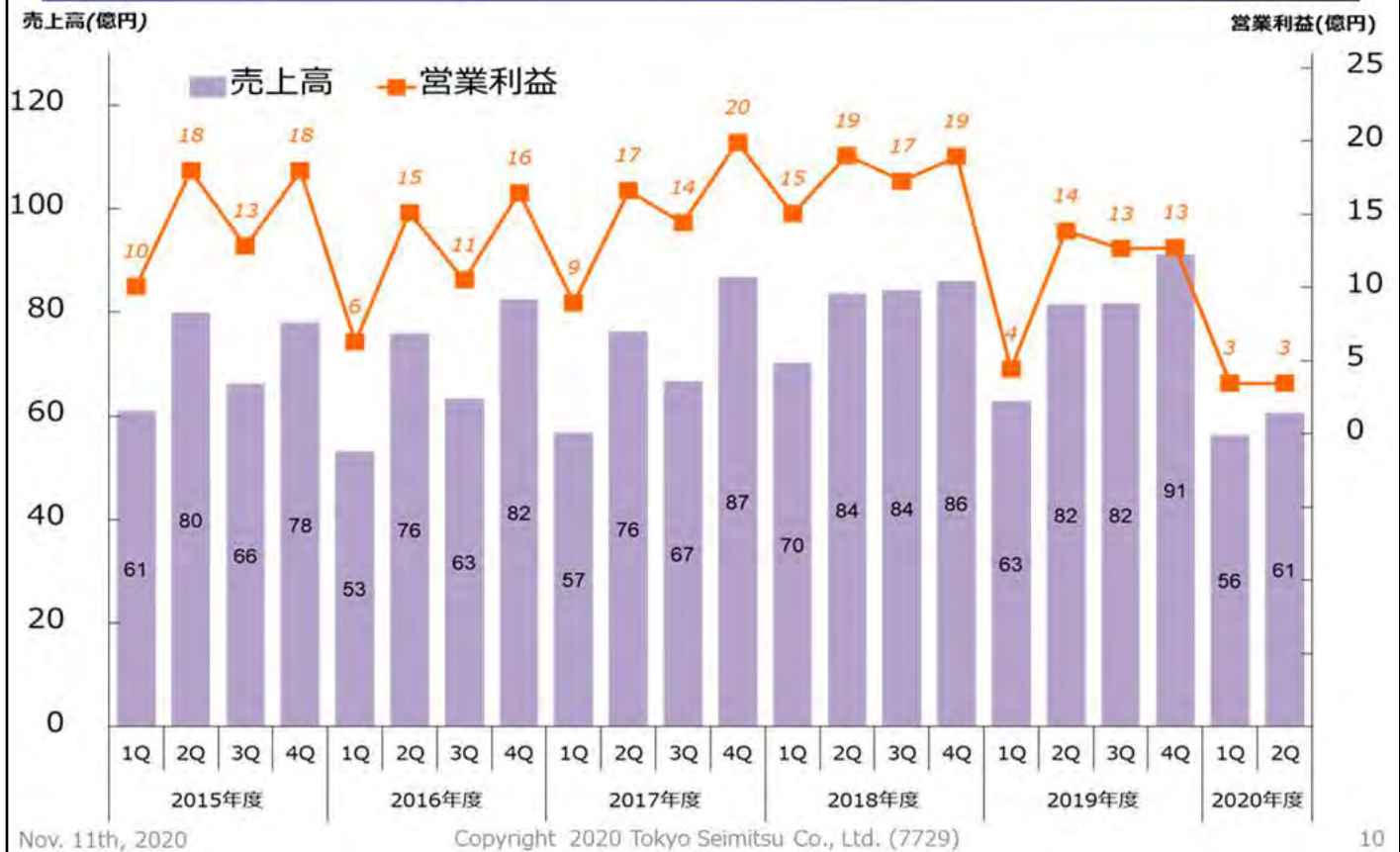
セグメント業績 (半期：億円)	2019年度		2020年度				
	上期	下期	上期	業績予想	予想対比	前半期比	前年同期比
受注高	154	144	108			-25%	-30%
売上高	144	173	117	115	+2	-32%	-19%
営業利益 (営業利益率)	18 (13%)	25 (15%)	6 (5%)			-76%	-67%

四半期業績(億円)	2019年度				2020年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	80	74	71	74	58	50	-13%	-33%
売上高	63	82	82	91	56	61	+8%	-26%
営業利益 (営業利益率)	4 (7%)	14 (17%)	13 (16%)	13 (14%)	3 (6%)	3 (4%)	-26%	-82%

- ▶ 上期は 新型コロナによる設備需要減少により、サービス・営業活動への影響を受け、減収減益
- ▶ 上期受注高も前年同期比、前半期比ともに減少

- 上期は、新型コロナウイルス感染症によるモノづくり業界全般における設備需要の減速に加え、サービス・営業活動への影響を受け、減収減益

# 計測 - 売上高, 営業利益



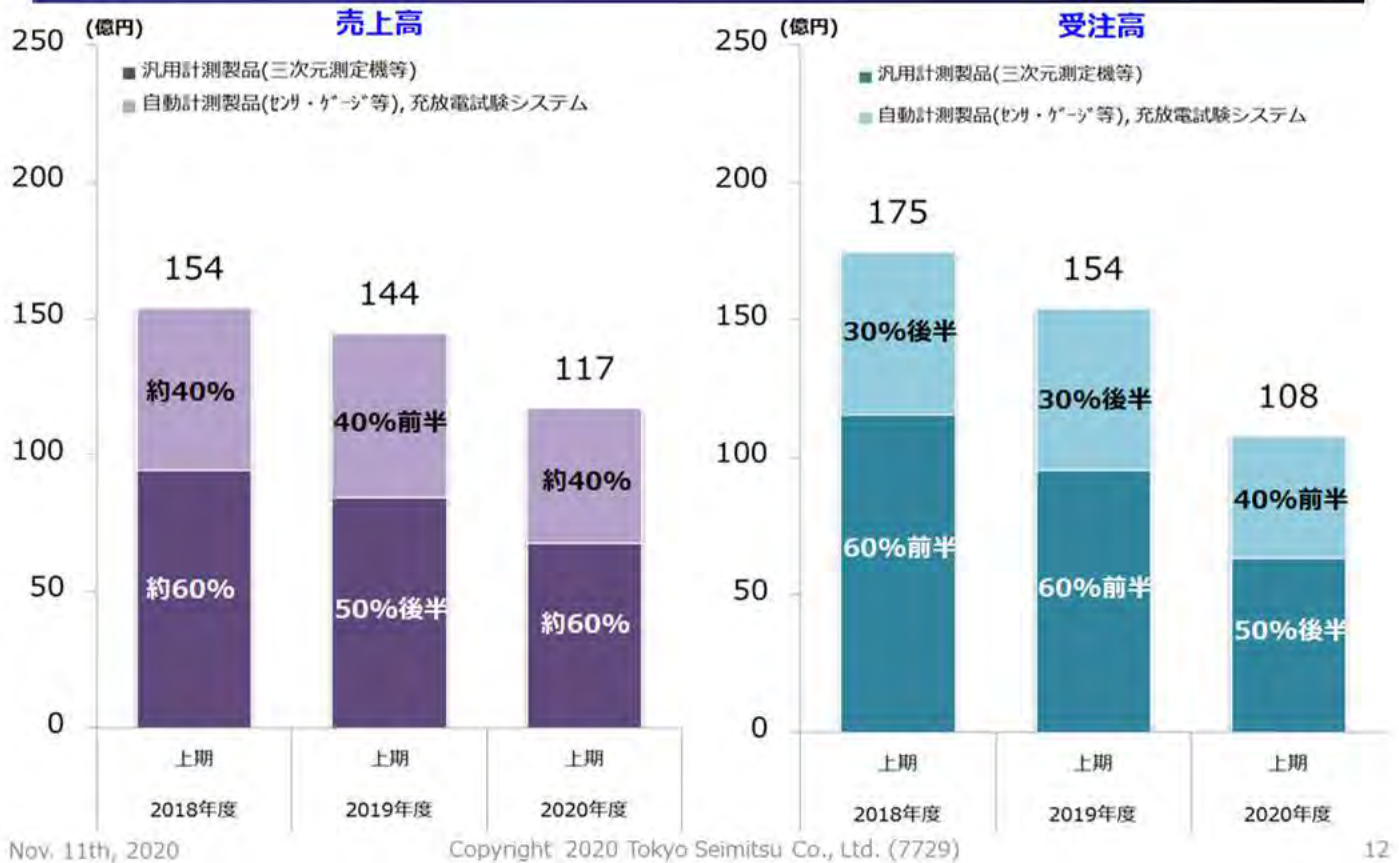
○ 第2四半期は出荷が進み, 第1四半期対比で増収

# 計測 - 受注高, 受注残高



- 2Q受注は、新型コロナウイルスによるモノづくり関連需要の低迷が継続し、1Q対比で減少
- 受注残高も 2Q売上増加により 減少

# 計測 - 製品別動向



○ 2020年度上期の製品別比率：

売上高：汎用計測製品 6割, 自動計測製品・充放電試験 4割

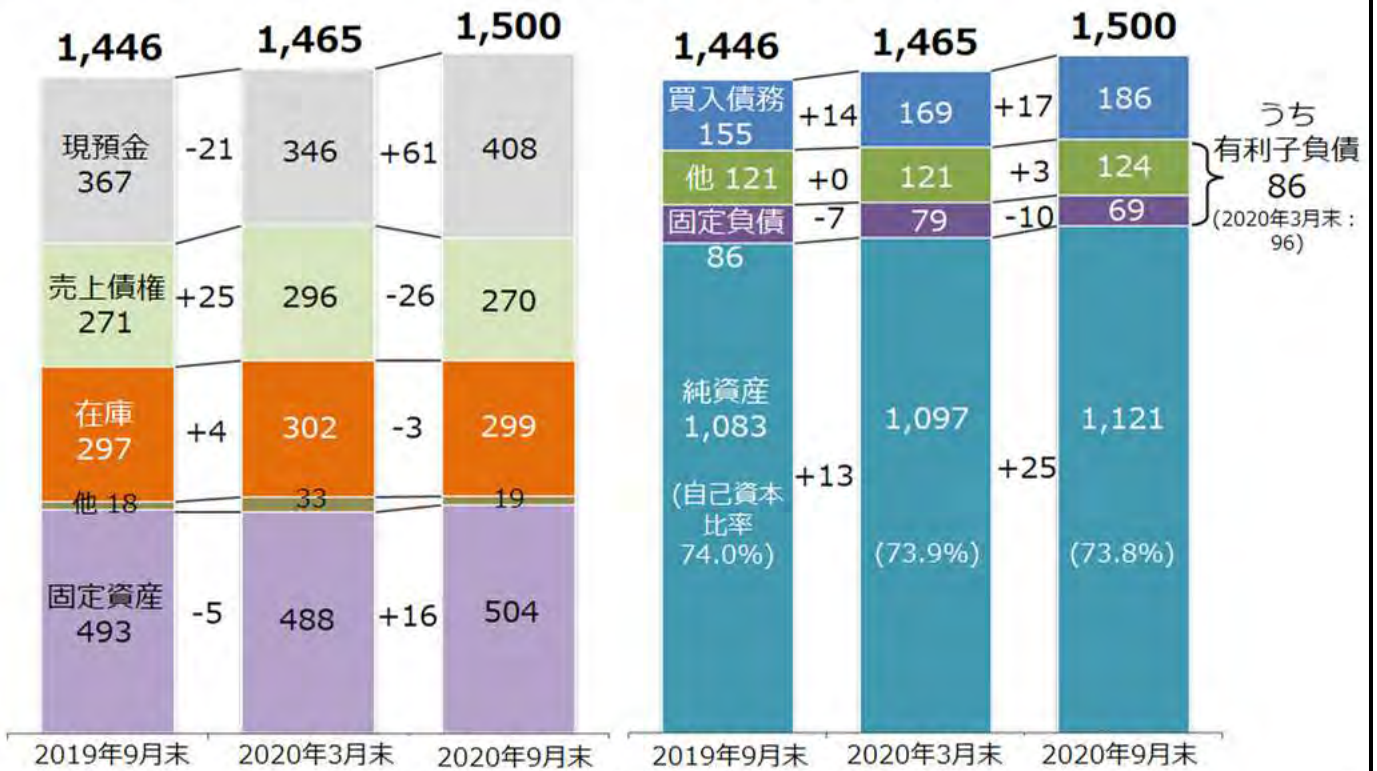
受注高：汎用計測製品 5割後半, 自動計測製品・充放電試験 4割前半

# 貸借対照表



## 資産の部(億円)

## 負債・純資産の部(億円)



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

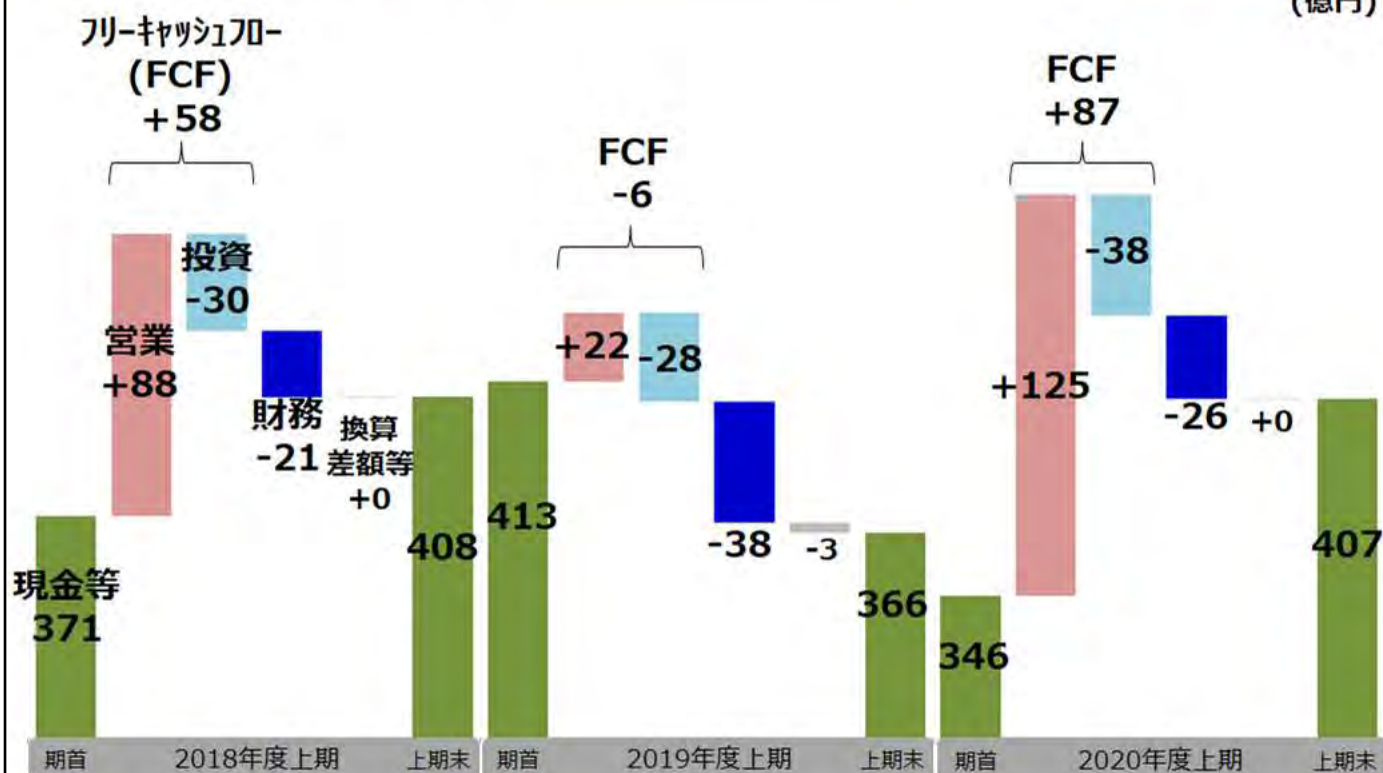
13

- 9月末の総資産は1,500億円 (3月末比 35億円増)
- 資産の部(左側)増減の内訳:  
 増加: 現預金61億円, 固定資産16億円  
 減少: 売上債権26億円、在庫3億円, その他流動資産14億円
- 負債・純資産の部(右側)増減の内訳  
 増加: 買入債務17億円, その他流動負債3億円, 純資産25億円  
 減少: 固定負債10億円
- 9月末の自己資本比率は 73.8%, 有利子負債残高は86億円

# キャッシュフロー(CF)



(億円)



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

14

- 2020年度上期キャッシュフロー(以下CF)
  - 営業CF: プラス125億円(主因:利益計上, 売掛・買掛などの増減)
  - 投資CF: マイナス38億円(設備投資等)
  - この結果, フリーCFは プラス87億円
  - 財務CF: マイナス26億円(配当支払, 借入金返済)
  
- 2020年度上期末の現金等の残高は 407億円

## 次第

- ◆ 2020年度 第2四半期 業績説明
- ◆ **2020年度 通期業績予想**
- ◆ 中期目標に関して
- ◆ 質疑応答

## 全体

- 新型コロナウイルス感染症収束は2021年度以降と見込む
- 米中貿易摩擦の影響を見定める必要がある

## 半導体

- 米中貿易摩擦の影響が懸念されるが、季節性による回復、5G関連の中国現地メーカー需要、電子部品需要は安定と予想
- 来たる市場拡大に備え、必要な研究開発・設備投資を継続

## 計測

- 受注は2Qに底打ちしたと予想するが、回復の勢いは緩慢
- 需要拡大基調にある半導体、NEV、医療分野への拡販を推進

- 2020年度通期の業績予想の前提
- 新型コロナウイルス感染症の収束は2021年度以降と見込む。  
米中貿易摩擦の影響を見定めていく
- 半導体：季節性による回復、5G関連中国メーカー、電子部品需要は安定推移  
中長期的な成長に備えて投資を継続
- 計測： 回復の勢いは緩慢、本格的な回復には時間を要する  
一方で、新しい市場への拡販を推進する



# 2020年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2019年度			2020年度			
	上期	下期	通期	上期	下期予	通期予	前期比
売上高	420	459	879	451	469	920	+5%
営業利益 (営業利益率)	56 (13%)	67 (15%)	123 (14%)	63 (14%)	69 (15%)	132 (14%)	+7%
経常利益	57	66	124	64	69	133	+8%
当期純利益	43	29	72	47	53	100	+40%
1株配当			76円			84円	+8円

## セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	229	348	577	288			
	売上高	276	286	562	334	350	684	+22%
(計測)	受注高	154	144	299	108			
	売上高	144	173	317	117	119	236	-26%

- ▶ 半導体の好調を受け、2020年度通期は増収増益を予想
- ▶ 通期業績予想の開示と併せて、配当を開示(中間42円, 期末予想42円)
- ▶ 自己株式の取得について決定

Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

17

### ○ 2020年度通期業績予想

売上高920億円(うち半導体684億円, 計測236億円)

営業利益132億円

経常利益133億円

当期純利益100億円

### ○ 通期配当は、1株あたり84円の予想(中間42円, 期末予想42円)

### ○ 自己株式の取得について決定

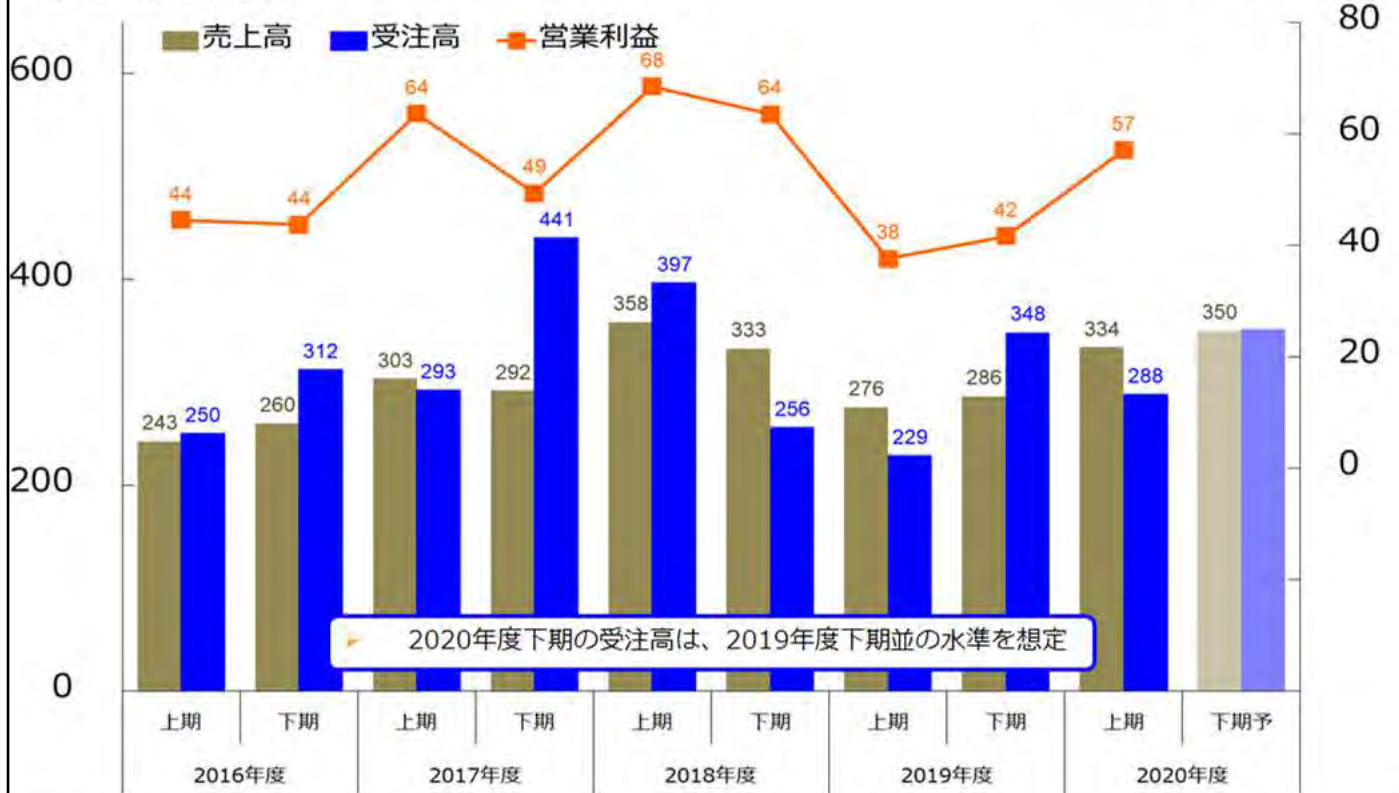
(業績予想, 配当, ならびに自己株式取得についての詳細は  
2020年11月11日付ニュースリリースをご覧ください)

# 半導体 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

18

- 2020年度下期の半導体受注高は、2019年度下期並みの水準を想定
- 2020年度下期予想の製品構成比の想定  
売上高・受注高共に：検査装置6割，加工装置4割

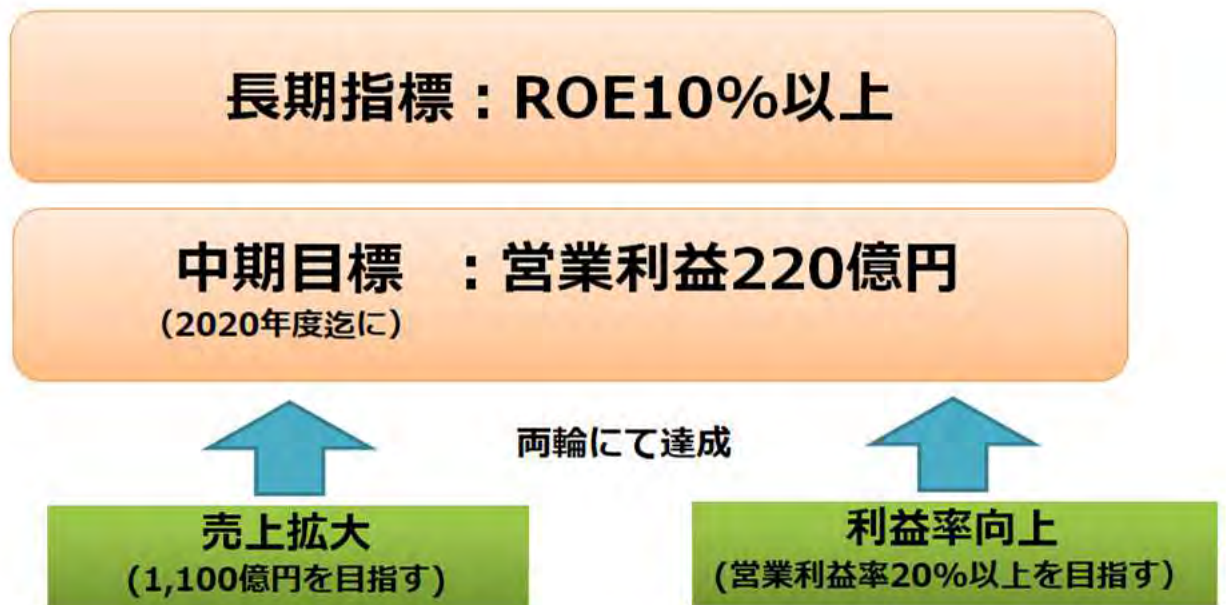
# 計測 - 売上・受注高 見込



- 2020年度下期の受注高は、緩やかな回復を想定
- 2020年度下期の製品構成比の想定  
 売上高・受注高共に：汎用計測製品 約6割,  
 自動計測製品・充放電試験システム合算 約4割

## 次第

- ◆ 2020年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2020年度 通期業績予想
- ◆ **中期目標に関して**
- ◆ 質疑応答



- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標: ROE 10%以上維持
- 中期目標: 2020年度迄に営業利益220億円達成
- 売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す

- 2020年度の市場環境は 前提の事業環境から大きく変化し、かつ連動性に欠ける状況を生み出している
  - 半導体：米中貿易摩擦による顧客需要の変動
  - 計測：新型コロナウイルス感染症拡大によるモノづくり停滞
  
- このため、**中期目標の終了年度を1年延期し、2021年度迄とする**
  - 定量目標、基本戦略に変更なし
  - ジャンプアップの為、必要な投資は計画通り実施
  - 持続的成長・企業価値向上に向けたESG活動を一層強化



- 現在の市場環境は、目標策定当初の前提から大きく変化し、かつ連動性に欠ける状況  
半導体：米中貿易摩擦を背景とした顧客需要の変動  
計測：新型コロナウイルス感染症拡大によるモノづくり停滞の継続
  
- したがって今年度終了予定であった中期目標を1年延期し、2021年度まで推進  
定量目標、基本戦略に変更なし  
今後のジャンプアップの為 必要な投資は 計画通り実施  
持続的成長・企業価値向上に向け、ESG活動の一層の強化を図る

## 技術面

製品競争力強化, 対象市場拡大

## 生産面

生産能力拡充, 効率改善(自動化, 省人化)

## 利益率改善

情報共有化促進  
サービス, 消耗品売上の拡充

中期目標達成



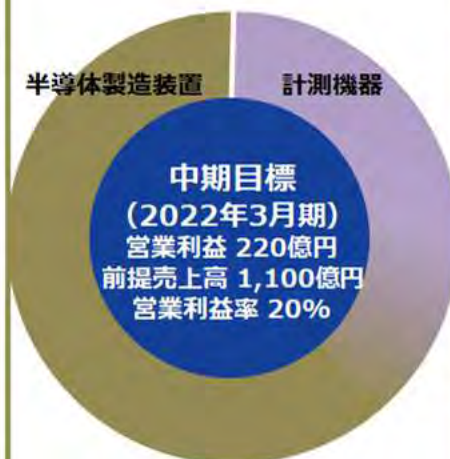
## 持続的な成長のために

積極的にESG活動を推進し, 企業価値向上を図る

- 当社の全社戦略は記載の通り、従前より変更はない
- 技術面: 既存製品の競争力を更に高め, 対象市場を更に拡大させる
- 生産面: 生産キャパシティの拡充と生産効率の改善を図る
- 利益率改善: 情報共有化の推進, 消耗品売上の拡充
- これらの目標達成を含めた持続的な成長のための基盤として ESG活動を積極的に推進したい

## 半導体製造装置

- 検査装置(プローバ)の“デパート化”戦略継続による 更なる市場拡大
- 加工装置のアプリケーション力強化・連動したサービスビジネス並びに消耗品売上の拡大
- 内製化促進, 新工場運用



## 計測機器

- 電気計測 (充放電試験) 進出による対象市場拡大, シナジーの最大化
- 既存製品群の差異化・国内外顧客開拓と, 連動したサービスビジネスの拡大
- 生産効率化・自動化



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

24

- 中期目標の前提となる売上高・利益構成並びに戦略は上記の通り基本的に変更はなく、利益率は両セグメントとも20%を目指す
- 半導体では、今後加速化が予想される市場の拡大を控え、製品やアプリケーション/サービスの対応力と、キャパシティを十分に備えることに注力
- 計測では、EV化の動きを前にして、電気計測分野へ進出これにより、当社の事業領域の拡大とシナジーの最大化を目指す



## キャパシティ拡充(半導体：日野工場, 美山工場)

- 美山工場：フル稼働継続
- 日野工場：新棟 2022年度竣工予定



## キャパシティ拡充 (計測：土浦MI棟)

- 2020年5月稼働開始
- 各種効率化・改善策を推進



MI: *Monozukuri Innovation*

## 効率化

- ERPによる  
業務改善・効率化  
取り組み継続

## アプリ対応強化 (台湾新アプリセンタ設立)

- 2021年5月稼働予定



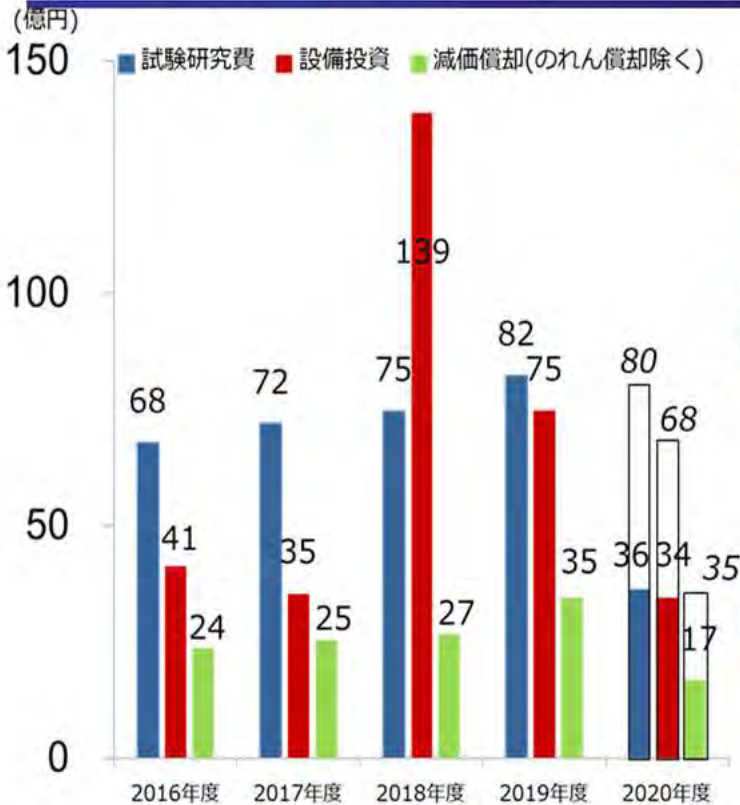
## アプリ対応強化 (大阪計測センタリニューアル)

- 2020年1月稼働開始



- キャパシティ拡充(上段)  
半導体：東京都八王子市 美山工場 フル稼働継続  
東京都日野市 日野工場 新棟 2022年度竣工予定  
計測：茨城県土浦市 土浦工場敷地内 新棟(MI棟) 5月稼働開始
- 効率化(下段左)  
ERPが安定稼働，業務改善や 効率を高める取り組みを継続
- アプリケーション対応強化(下段中央・右)は，計画通り進行中

# 試験研究費, 設備投資, 減価償却



## 研究開発：製品力強化・競争力維持

➤ 売上高対比10%内を目安に強化

## 設備投資：能力増強・効率化等

➤ 成長に向けた投資を継続  
(新工場, 自動化, アプリセンタ等)

➤ 2020年度見通しは支出期ずれにより  
引き下げ(88億円→68億円)

## 減価償却

➤ 2020年度計画 変更なし

➤ 2021年度以降は軽微な増加を見込む

Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

26

- 試験研究費：売上高の10%以内を目安に強化  
2020年度上期実績36億円, 通期計画80億円
- 設備投資：中期目標の期間内で200億円超  
2020年度上期実績34億円  
通期計画は支出期ずれにより88億円から68億円へ変更
- 減価償却：2020年度上期実績17億円, 通期計画35億円



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

27

- 持続可能な社会の実現に向けたステークホルダーとのかかわりは記載の通り
- 当社グループは、今後もお客様の新しい挑戦を支援する強力なパートナーであり続け、サプライヤとの協働で共に成長し続けていく  
そのために、従業員の能力開発を進め、各ステークホルダーとのコミュニケーションを更に進化させていきたい

● 重要課題 (マテリアリティ)

環境	製品を通じての環境貢献 (エコプロダクツ)
	事業活動を通じての環境貢献 (エコファクトリー)
社会	製品を通じての価値提供
	持続可能なサプライチェーン の強化
	働きがいのある職場づくり
ガバナンス	経営基盤の強化
	コンプライアンスの強化

● 2020 年度上期 ESG の主な取り組み

Environment (環境)

- ・ 環境配慮型製品の開発：LCA\*を考慮した開発を継続
- ・ 温暖化防止：低炭素電力使用拡大、CO2 排出削減
- ・ 資源削減：水/紙 使用量低減、廃棄物リサイクル率向上

\* LCA : Life Cycle Assessment

Social (社会)

- ・ 職場環境：働き方改革、女性活躍推進、健康企業宣言
- ・ 品質、安全：QMS活動・安全教育の展開
- ・ サプライチェーン：協働でのCSR活動推進

Governance (ガバナンス)

- ・ コンプライアンス：遵守体制・情報セキュリティ強化
- ・ リスクマネジメント：事業継続計画 (BCP) 強化

- 当社がESG活動において定めているマテリアリティ(重要課題)と、それに即した活動は表記の通り

# ISO26000の中核主題と対応SDGs

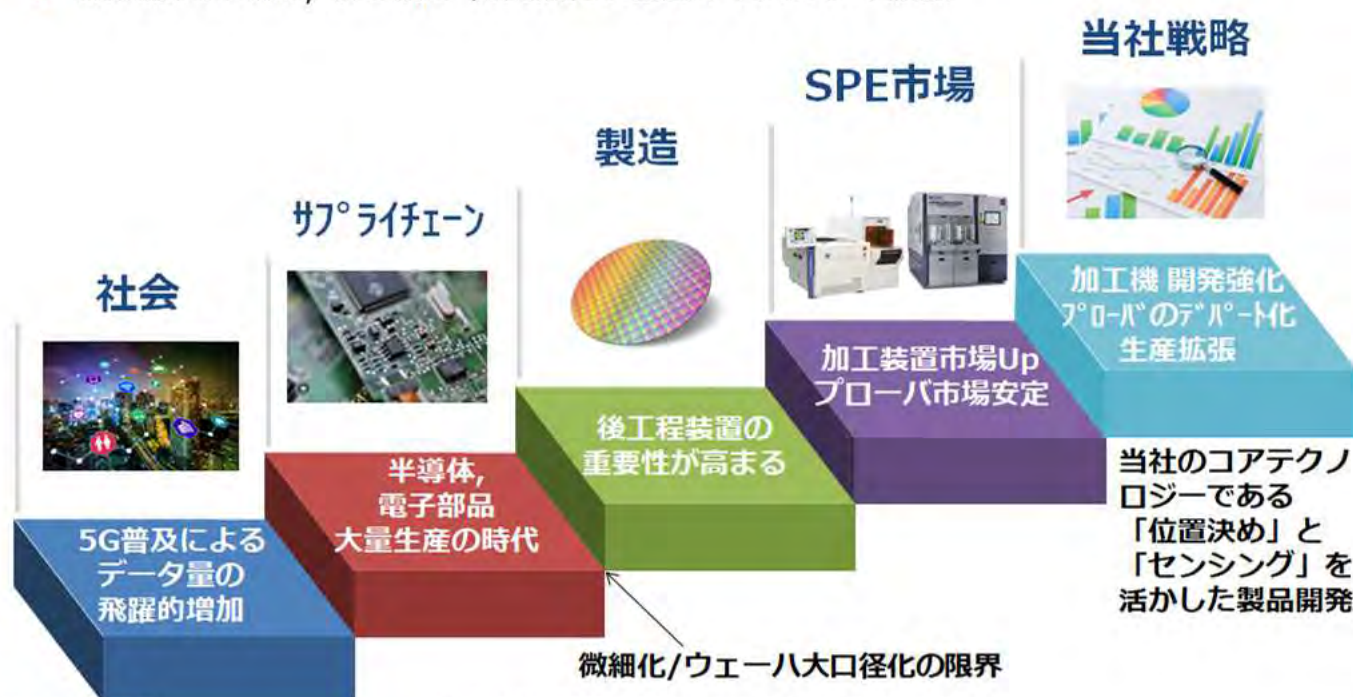


ISO 26000 の中核主題	当社の取り組み (要約)	対応する SDGs
組織統治	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コーポレートガバナンス</li> <li>●リスク管理、品質コンプライアンス</li> </ul>	
人権	<ul style="list-style-type: none"> <li>●グループ行動規範</li> <li>●多様な働き方・人材への取り組み</li> </ul>	
労働慣行	<ul style="list-style-type: none"> <li>●グローバルで細やかなサポート体制</li> <li>●サプライチェーン強化</li> </ul>	
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>●地球環境とのかかわり</li> <li>●エコプロダクツ・エコファクトリー</li> </ul>	
消費者課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>●顧客満足度追及</li> <li>●サプライチェーン強化</li> <li>●エコプロダクツ</li> </ul>	
コミュニティの発展	<ul style="list-style-type: none"> <li>●従業員と家族の健康への取り組み</li> <li>●人材開発</li> <li>●地域社会・業界団体とのかかわり</li> </ul>	

- 現在当社が取り組んでいるESG活動の内容を、ISO26000の中核主題とSDGsに沿って整理したもの
- 今後は、ISO26000の中核主題のみならず、SDGsへの対応を進め、活動の拡充を図っていく

# 次期 中期目標の前提(半導体)

- 5G普及により、半導体・電子部品の 桁違いの大量生産・大量消費の時代へ
- その結果、後工程SPEの重要性が高まると予想
- 業績拡大の軸は、引き続き 開発強化と生産キャパシティ拡張



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

30

- 現在の中期目標の次に策定すべき 中期目標の前提となる考え方 (半導体)
- 5G普及によるデータ量の飛躍的な増加は、半導体・電子部品の大量生産・大量消費につながる
- また前工程の技術的な制約から、後工程の重要性が生産性・機能の両面で高まる
- その結果加工装置の需要増加、検査装置の安定した市場が期待できる
- 当社としては コアテクノロジーである「位置決め」と「センシング」を活かした製品開発強化、生産キャパシティ拡充を軸とした戦略をとる

- 内燃機関の測定需要は、EVの広まりを受け、緩やかな減少を見込む
- 他方で、自動化(IoT)と、EV バッテリ + モータ測定需要に大きな期待
- 業績拡大の軸は、製品ラインナップおよび参入分野の拡大と、海外売上増加



Nov. 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

31

- 自動車内燃機関測定需要は、EVの広まりを受け、緩やかな減少を予想
- 他方で、計測自動化、EV関連測定の盛り上がり期待
- 加えて、非自動車/成長業界と考えられる  
半導体・航空機・医療などの需要にも期待
- 当社としては、製品ラインナップおよび参入分野の拡大と、  
海外売上増加を軸とした戦略をとる

## 次第

- ◆ 2020年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2020年度 通期業績予想
- ◆ 中期目標に関して
- ◆ **質疑応答**





<https://www.accretech.jp/>  
<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>



# 補足資料

# セグメント別業績推移



(百万円)	会計期間				四半期							
	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期 上期	2020年3月期				2021年3月期			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
調注 高	半導体	73,327	65,335	57,709	28,835	10,694	12,177	15,375	19,462	12,903	15,932	
	計測	30,651	33,573	29,866	10,776	7,974	7,446	7,086	7,359	5,754	5,022	
	合計	103,979	98,909	87,576	39,612	18,668	19,624	22,461	26,821	18,657	20,955	
調注 高	半導体	31,452	27,670	29,182	24,610	26,689	22,991	24,303	29,182	26,653	24,610	
	計測	7,996	9,165	7,782	6,855	11,333	10,623	9,538	7,782	7,898	6,855	
	合計	39,448	36,836	36,965	31,465	38,022	33,615	33,842	36,965	34,552	31,465	
売上 高	半導体	59,523	69,117	56,198	33,407	11,676	15,874	14,063	14,583	15,432	17,975	
	計測	28,671	32,403	31,728	11,704	6,285	8,157	8,170	9,115	5,638	6,066	
	合計	88,194	101,520	87,927	45,112	17,962	24,031	22,233	23,698	21,070	24,041	
営業 利益	半導体	11,292	13,195	7,915	5,682	1,358	2,399	2,111	2,046	2,832	2,850	
	計測	5,990	7,025	4,366	599	443	1,387	1,265	1,270	344	255	
	合計	17,283	20,221	12,282	6,282	1,802	3,786	3,376	3,317	3,176	3,105	
営業 利益 率	半導体	19.0%	19.1%	14.1%	17.0%	11.6%	15.1%	15.0%	14.0%	18.4%	15.9%	
	計測	20.9%	21.7%	13.8%	5.1%	7.1%	17.0%	15.5%	13.9%	6.1%	4.2%	
	合計	19.6%	19.9%	14.0%	13.9%	10.0%	15.8%	15.2%	14.0%	15.1%	12.9%	

# 損益計算書



(百万円)	会計期間				四半期									
	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期 上期	2020年3月期				2021年3月期					
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	88,194	101,520	87,927	45,112	17,962	24,031	22,233	23,698	21,070	24,041				
売上原価	53,818	60,430	53,452	28,296	10,862	14,687	13,357	14,544	12,863	15,433				
売上総利益	34,375	41,090	34,474	16,815	7,100	9,344	8,876	9,154	8,207	8,608				
販売費および一般管理費	17,092	20,869	22,192	10,533	5,297	5,557	5,499	5,837	5,030	5,502				
営業利益	17,283	20,221	12,282	6,282	1,802	3,786	3,376	3,317	3,176	3,105				
営業外収益	170	688	255	219	131	78	102	-57	194	118				
営業外費用	138	104	177	85	38	18	51	68	25	153				
経常利益	17,316	20,805	12,360	6,415	1,895	3,846	3,426	3,191	3,345	3,070				
特別利益	4	58	57	6	2	10	43	1	6	-				
特別損失	2	419	1,712	293	-	-	42	1,669	-	293				
税引前利益	17,318	20,443	10,705	6,127	1,897	3,856	3,427	1,523	3,351	2,776				
法人税等合計	4,542	5,719	3,598	1,459	505	1,009	1,153	930	886	573				
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,717	14,665	7,156	4,677	1,402	2,859	2,281	613	2,470	2,207				
1株当たり当期純利益(円)	306.41	352.92	171.89	112.27	33.70	68.69	54.80	14.73	59.30	52.98				
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円)	304.02	350.23	170.72	111.45	-	-	-	-	-	-				

# 貸借対照表



(百万円)		2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期 (2Q末)
流動資産	現金及び預金	37,220	41,518	34,640	40,776
	売上債権※1	33,439	36,146	29,633	27,029
	在庫	22,325	29,995	30,152	29,898
	その他	3,364	2,434	3,345	1,878
	合計	96,349	110,094	97,771	99,584
固定資産合計		36,645	47,478	48,777	50,368
総資産		132,995	157,573	146,549	149,952
流動負債	買入債務※2	21,870	26,328	16,895	18,570
	その他	10,936	14,620	12,121	12,377
	合計	32,807	40,948	29,017	30,950
固定負債合計		833	9,220	7,857	6,872
負債合計		33,640	50,169	36,874	37,823
純資産合計		99,354	107,403	109,674	112,129
負債・純資産合計		132,995	157,573	146,549	149,952
有利子負債合計		1,351	11,415	9,641	8,616
自己資本比率		74.0%	67.3%	73.9%	73.8%
自己資本利益率(ROE)		13.8%	14.4%	6.7%	-

※1: 電子記録債権を含む ※2: 電子記録債務を含む

# 各種費用, キャッシュフロー



(百万円)	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期 (上期)
試験研究費	7,194	7,469	8,234	3,634
設備投資	3,547	13,872	7,477	3,442
減価償却費(のれん除く)	2,541	2,655	3,450	1,674

(百万円)	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期 (上期)
営業活動によるキャッシュフロー	10,931	12,932	5,965	12,517
投資活動によるキャッシュフロー	-4,649	-13,952	-6,116	-3,767
フリーキャッシュフロー	6,281	-1,020	-150	8,750
財務活動によるキャッシュフロー	-3,163	5,443	-6,375	-2,613
現金及び現金同等物に係る 換算差額等	147	-223	-159	3
現金及び現金同等物の期末残高	37,090	41,290	34,605	40,745

# 従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算